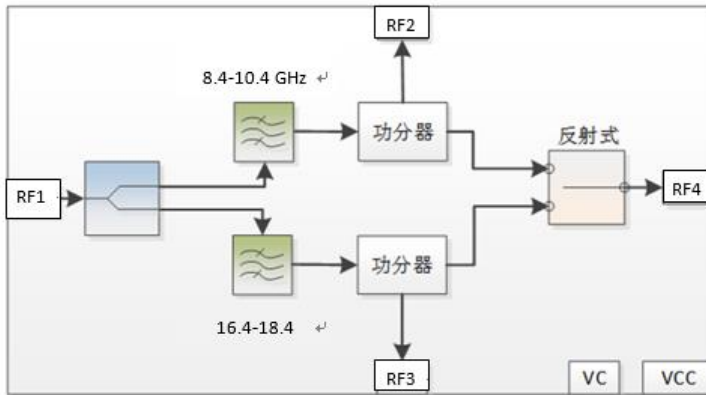


性能特点：

- 频带：8.4-10.4GHz& 16.4-18.4GHz
- 通带损耗：15dB
- 输入/输出回波损耗：14dB/14dB
- 带外抑制(8.4-10.4GHz)：40@DC-7GHz&12.5-20GHz
- 带外抑制(16.4-18.4GHz)：40@DC-13GHz&22-37GHz
- 隔离度：40dB
- VCC 供电电压：-5V
- VC 控制方式:TTL 兼容 LVTTTL
- 芯片尺寸：4.0mm×4.0mm×0.1mm

产品简介：

HH-MF0218E 是一款 GaAs MMIC 滤波多功能芯片，其频率范围覆盖 8.4~10.4GHz& 16.4~18.4GHz，整个带内插入损耗为 15dB。HH-MF0218E 采用-5V 供电。

功能图：

电参数： (TA=25°C)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	8.4-10.4 & 16.4-18.4			GHz
通带损耗	-	15	-	dB
输入输出回波损耗	-	14	-	dB
带外抑制(8.4-10.4GHz) @DC-7GHz&12.5-20GHz	-	40	-	dBc
带外抑制(16.4-18.4GHz) @DC-13GHz&22-37GHz	-	40	-	dBc
隔离度	36	40	-	dB

使用限制参数：

输入功率	+23dBm
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~85°C

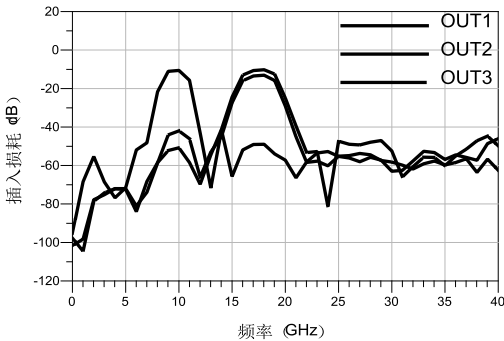
真值表：

VCC	VC	RF4 输出通带频率
-5V	+5V	8.4-10.4 GHz
-5V	0V	16.4-18.4GHz

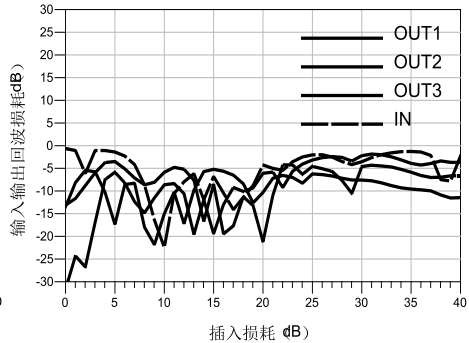
典型曲线：

VC=0V

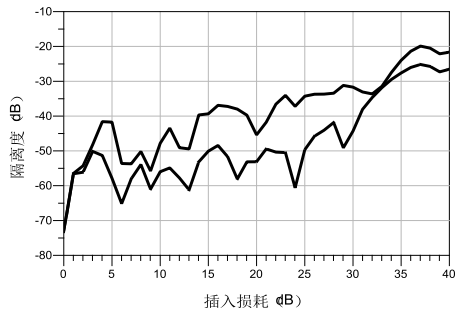
插入损耗



输入输出回波损耗



隔离度

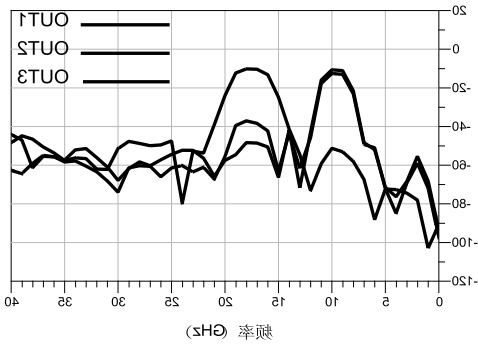


VC=5V

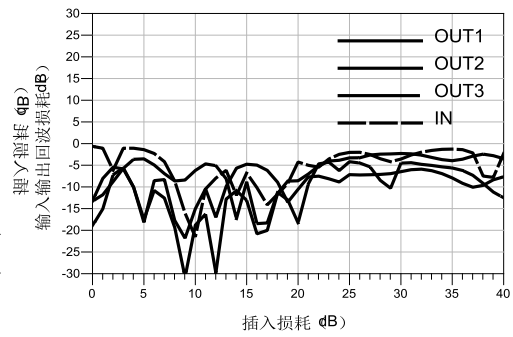
14

开关滤波多功能

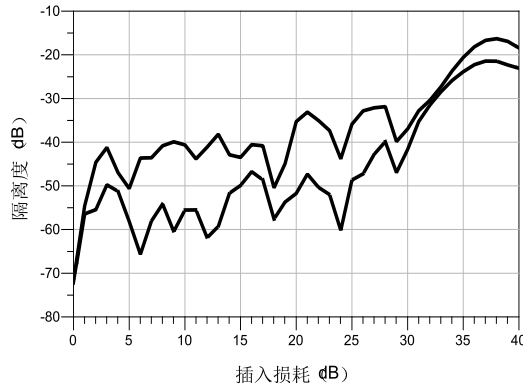
插入损耗



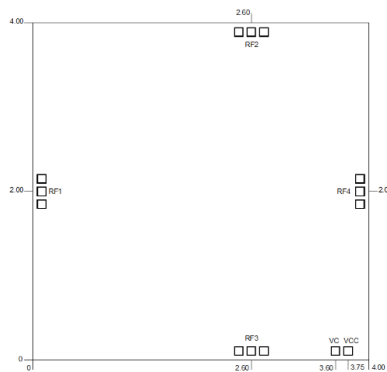
输入输出回波损耗



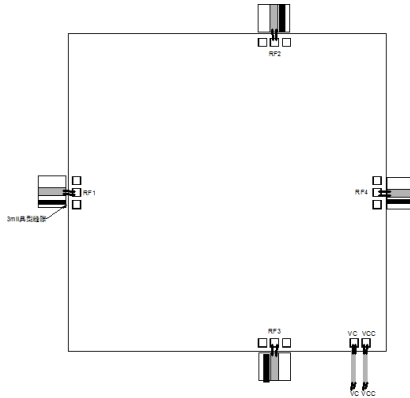
隔离度



尺寸图 : (单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。